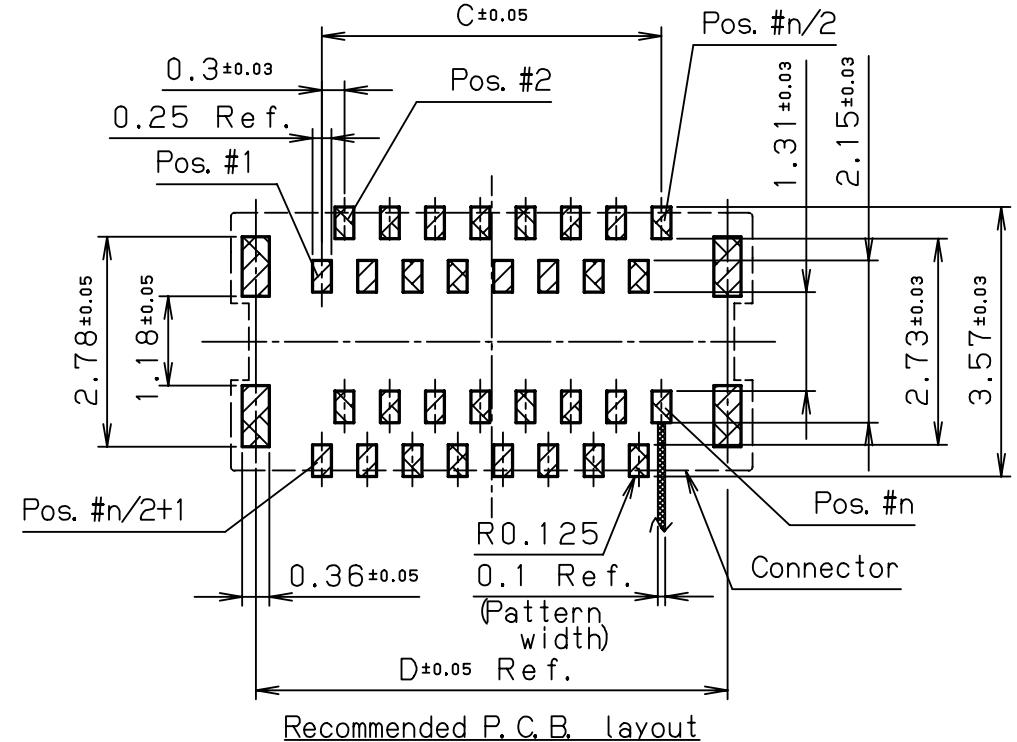


- Note 1. Contact Plating
 Contact area: Gold 0.1μm
 Terminal area: Gold flash
 Underplating: Nickel
 (Under the use of N2-reflow excluded.)
2. Mating Connector
 P/N: LPZ-E()SFY+
3. Contact and Hold down co-planarity is 0.08mm MAX.



HONDA
 PRINT RM
 JLY.21.2006
 ISSUED

Table-1

Part No.	n	A	B	C	D
LPZ-24SMY+	24	5.71	3.96	3.3	5.05
LPZ-32SMY+	32	6.91	5.16	4.5	6.25
LPZ-40SMY+	40	8.11	6.36	5.7	7.45
LPZ-60SMY+	60	11.11	9.36	8.7	10.45

△				3	Hold down	Copper alloy	2	Gold flash	
△				2	Contact	Copper alloy	n	See Note #1	
△				1	Insulator	LCP (GF)	1		UL94V-0 Black
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.					
Jly.21 (2006)	10/1	mm (INCH)	3RD. A. P	製 名	0.3mm pitch stacking plus connector SMT termination type. (Stack height is 0.7mm)				
DR.	DE.	CHK.	CHK.	承 認	名 称				
K. KUWANA	K. KUWANA	K. TAKAHASHI		K. KASAI	NAME				
					製 番				
					PART NO.	LPZ- () SMY+			
						REV.			